

## 電子式自動整合器

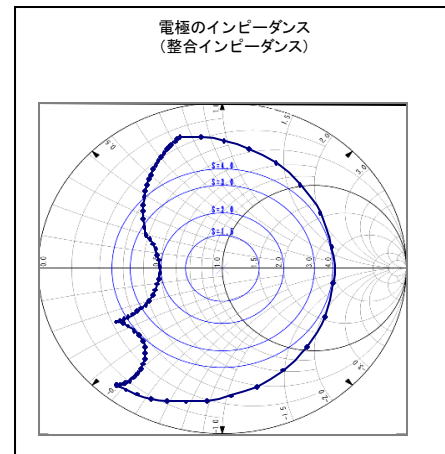
# EMB-1K-FD

半導体式高周波スイッチ技術を取り入れ、可変コンデンサなどの可動部分を排した、電子式自動整合器です。メカニカルレス設計のために、高速・高寿命の運転が可能です。

### 仕様・定格

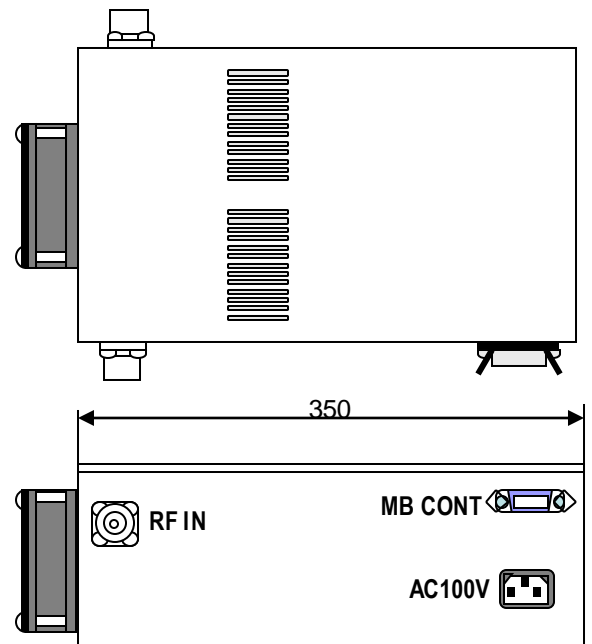
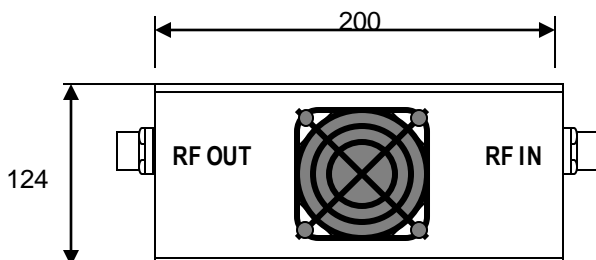
No	項目	仕様
1	周波数	13.56MHz
2	通過電力	1kW
3	ネットワーク形式	Π型
4	整合範囲	右表
5	整合精度	SWR<1.2
6	整合時間	1秒以内
7	入力コネクタ	N-R型
8	出力コネクタ	N-R型
9	電源入力	AC100V100VA
10	制御コネクタ	#57-30140
11	セット内容	1 本体 2 リモコン(タッチパネル) 3 ケーブル式

### 整合範囲

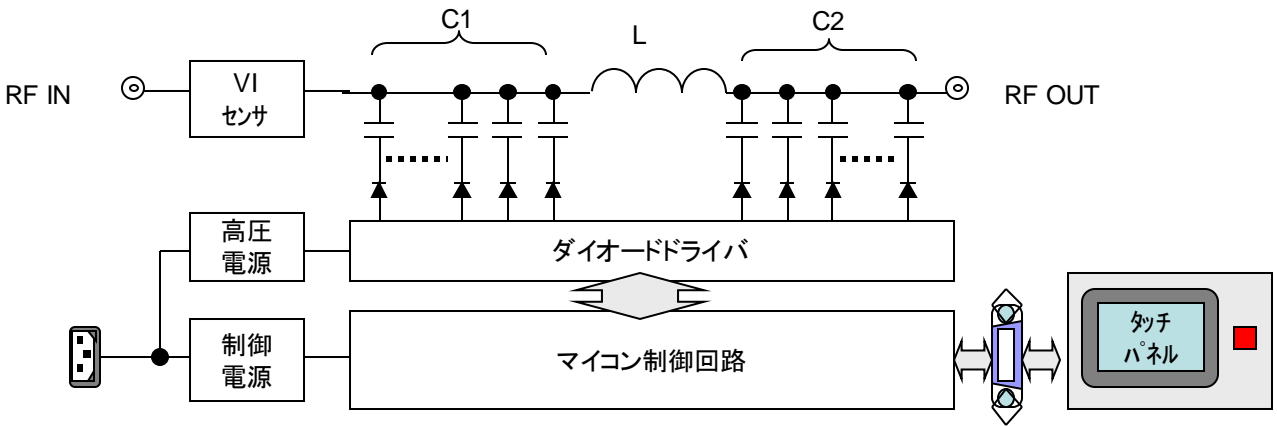


### 外形寸法

本図は、概要を示すもので、やや誇張しています。詳細は別途外形図をご要求下さい。



ブロック図



動作解説

本機の構成は上図の通りのπ型整合器を基本とし、その可変コンデンサC1・C2を半導体スイッチで並列加算し任意の数値を得ることが出来ます。

この半導体スイッチはPINダイオードを利用しており、逆電圧でOFF・順電圧でONとなるようなモジュール構造となります。

一方、入力された、高周波はVIセンサにより、整合点からどの程度離調しているか(インピーダンス・位相)情報をマイコンに引き渡します。

この情報により、マイコンではC1・C2の増減をおこない、整合を完了します。

操作画面



タッチパネルの画面例です。

本パネル上で表示されるもの

C1数値 C2数値 Pf(進行波電力) Pr(反射波電力)

本パネルで設定可能なもの

C1数値 C2数値 C1自動/手動 C2自動/手動

画面は一例です。製品版は若干異なります。